

关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况  
专项报告的鉴证报告  
信会师报字[2026]第 ZI10020 号



关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况  
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZI10020号

盛美半导体设备（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映贵公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表



鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2026年2月26日

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制作费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕第ZI10561号《验资报告》。

##### 2、 2024年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1338号）核准，公司于2025年9月完成向特定对象发行人民币普通股（A股）38,601,326股，发行价格为116.11元/股，募集资金总额为人民币4,481,999,961.86元，扣除各项发行费用人民币46,984,264.81元（不含增值税），募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2025〕第ZI10808号《验资报告》。

## （二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

### 1、首次公开发行股票募集资金

项目	募集资金发生情况（人民币元）
2024年募集资金结余金额	523,844,590.03
减：本报告期募集资金使用金额	71,137,816.05
减：手续费	11,256.93
加：利息收入	1,880,825.26
2025年末募集资金结余金额	454,576,342.31

### 2、2024年度向特定对象发行股票募集资金

项目	募集资金发生情况（人民币元）
募集资金净额	4,435,015,697.05
减：本报告期募集资金使用金额	1,139,341,841.68
减：手续费	26,903.30
加：利息收入	496,355.51
2025年末募集资金结余金额	3,296,143,307.58

注：募集资金结余金额详情见本专项报告二、（二），三、（三）及三、（四）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

#### 1、首次公开发行股票募集资金

2021年11月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中国工商银行股份有限公司上海自贸

试验区新片区分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与招商银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年10月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2024年6月，公司及全资孙公司ACM RESEARCH KOREA CO., LTD.和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）与KB Kookmin Bank Seongnam Hi-tech valley Branch共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行已于2023年5月15日销户，上海银行股份有限公司浦东分行已于2023年5月22日销户，中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行已于2024年8月23日销户，招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行已于2024年11月7日销户，宁波银行股份有限公司上海长宁支行已于2024年11月28日销户，中国光大银行股份有限公司上海昌里支行已于2024年12月17日销户，KB Kookmin Bank Seongnam Hi-tech valley Branch已于2025年2月21日销户。截至2025年12月31日，其他上述监管协议履行正常。

## 2、2024年度向特定对象发行股票募集资金

2025年9月，公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国光大银行股份有限公司上海昌里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司与国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

## （二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

### 1、首次公开发行股票募集资金

开户银行名称	银行账号	金额(人民币元)	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121909929210918	114,032,793.43	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	97080078801900002063	50.80	活期存款
招商银行股份有限公司上海淮海支行	121909929210202	25,707.38	活期存款
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156371	491,392.10	活期存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210666	26,697.43	活期存款
合计		114,576,641.14	

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额 454,576,342.31 元差异 339,999,701.17 元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 90,000,000.00 元，以及使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额 249,999,701.17 元。详见本专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”及“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

### 2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金

开户银行名称	银行账号	金额(人民币元)	备注
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	458548927208	296,965,253.48	活期存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121938866210008	351,210,838.34	活期存款
中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区拱极路支行	1001740619300212673	74,531,993.49	活期存款
招商银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行	121909929210018	450,628.28	活期存款
上海银行股份有限公司张江支行	03006344991	122,582,286.98	活期存款
中国光大银行股份有限公司上海昌里支行	36750180800806631	150,402,307.01	活期存款
合计		996,143,307.58	

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额 3,296,143,307.58 元差异 2,300,000,000.00 元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 2,300,000,000.00 元。详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 123,460,350.02 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-076）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。2025 年 6 月 20 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 25,000.00 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行临时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 249,999,701.17 元。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

公司于2025年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-077）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（元）	年化收益率
兴业银行股份有限公司上海市北支行	大额存单	2023.1.31	2026.1.31	90,000,000.00	3.15%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	2025.11.14	2026.11.14	500,000,000.00	1.40%
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	大额存单	2025.12.24	2026.12.24	1,800,000,000.00	1.20%
合计				2,390,000,000.00	

#### （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金24,500.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。变更后，“盛美半导体设备研发与制造中心”总投资额维持156,890.00万元不变，募集资金投入金额将增加至144,500.00万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹资金补足。该事项于2025年2月11日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。

本年度，公司不存在将超募资金用于回购公司股份并注销的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （七）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-047），首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。截至2025年12月31日，“盛美半导体设备研发与制造中心”项目尚未使用募集资金余额为该项目需用于支付已签订合同但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据2024年度向特定对象发行股票募集资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-075）。

公司于2025年11月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金92,234.85万元向公司全资子公司盛帷半导体设备（上海）有限公司增资以实施“研发和工艺测试平台建设项目”。具体内容详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-086）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金24,500.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。公司变更募投项目情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于 2026 年 2 月 26 日经董事会批准报出。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年2月26日



附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位:人民币元

募集资金总额(注1)		3,481,258,520.34		本年度投入募集资金总额		71,137,816.05					
变更用途的募集资金总额		245,000,000.00(注2)		已累计投入募集资金总额		3,137,606,532.38					
变更用途的募集资金总额比例		7.04%(注2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盛美半导体设备研发与制造中心	是	700,000,000.00	1,445,000,000.00	1,445,000,000.00	71,137,816.05	1,288,671,684.17	89.18	2025年6月	2.96亿元	是	否
盛美半导体高端半导体设备研发项目(注4)	不适用	450,000,000.00	不适用	450,000,000.00	不适用	454,587,394.44	101.02	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	650,000,000.00	不适用	650,000,000.00	不适用	650,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
高端半导体设备拓展研发项目(注4)	不适用	730,871,500.00	不适用	730,871,500.00	不适用	744,347,453.77	101.84	不适用	不适用	不适用	否
盛美韩国半导体设备研发与制造中心	是	245,000,000.00	0.00	0.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
合计		2,775,871,500.00	3,275,871,500.00	3,275,871,500.00	71,137,816.05	3,137,606,532.38	95.78				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无									
项目可行性发生重大变化的情况说明		终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目的原因为:由于2024年上半年全球营商环境的变化,公司经审慎评估后认为,通过“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目对盛美韩国进行大规模固定资产投资将面临风险。2024年12月2日公司及盛美韩国被美国工业和安全局(BIS)列入“实体清单”,也印证了公司前期的预判。基于上述原因,为了更好地维护公司和股东的利益,规避因全球营商环境变化带来的风险,提高募集资金使用效率,公司经过审慎研究决定终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见专项报告三、(三)									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		见专项报告三、(四)									



用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	见专项报告三、(七)

注 1: “募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 3,481,258,520.34 元。

注 2: “变更用途的募集资金总额”是指公司于 2025 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》, 同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”, 并将该项目拟投入募集资金 24,500.00 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更至首次公开发行招股募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。该事项于 2025 年 2 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号: 2025-004)。本处“变更用途的募集资金总额”不包括募集资金利息以及理财收益。

注 3: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4: 项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

附表 2:

2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位: 人民币元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额(注1)		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额	
		4,435,015,697.05		4,435,015,697.05		无		无		1,139,341,841.68		1,139,341,841.68	
变更用途的募集资金总额比例		无		无		无		无		1,139,341,841.68		1,139,341,841.68	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
研发和工艺测试平台建设	不适用	922,348,496.29	922,348,496.29	922,348,496.29	71,230,167.79	71,230,167.79	-851,118,328.50	7.72	不适用	不适用	不适用	否	
高端半导体设备迭代研发	不适用	2,255,470,824.90	2,208,486,535.19	2,208,486,535.19	111,802,451.88	111,802,451.88	-2,096,684,083.31	5.06	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	不适用	1,304,180,678.81	1,304,180,665.57	1,304,180,665.57	956,309,222.01	956,309,222.01	-347,871,443.56	73.33	不适用	不适用	不适用	否	
合计		4,482,000,000.00	4,435,015,697.05	4,435,015,697.05	1,139,341,841.68	1,139,341,841.68	-3,295,673,855.37	25.69					
未达到计划进度原因(分具体投资项目)													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
见专项报告三、(二)													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
无													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况													
见专项报告三、(四)													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
无													
募集资金结余的金额及形成原因													
无													
募集资金其他使用情况													
见专项报告三、(七)													

注 1: “募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 4,435,015,697.05 元。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

单位: 人民币元

编制单位: 盛美半导体设备(上海)股份有限公司

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	盛美韩国半导体设备研发与制造中心									
合计		1,445,000,000.00	1,445,000,000.00	71,137,816.05	1,288,671,684.17	89.18	2025 年 6 月	见附表 1	见附表 1	否
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)</p> <p>公司于 2025 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》, 同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”, 并将该项目拟投入募集资金 24,500.00 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。该事项于 2025 年 2 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号: 2025-004)。</p> <p>终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目的原因为:</p> <p>由于 2024 年上半年全球营商环境的变化, 公司经审慎评估后认为, 通过“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目对盛美韩国进行大规模固定资产投资将面临风险。2024 年 12 月 2 日公司及盛美韩国被美国工业和安全局(BIS)列入“实体清单”, 也印证了公司前期的预判。</p> <p>基于上述原因, 为了更好地维护公司和股东的利益, 规避因全球营商环境变化带来的风险, 提高募集资金使用效率, 公司经过审慎研究决定终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目。</p>										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										